

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. Mai 2005 (19.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/044505 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B23K 26/06**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/012723

(22) Internationales Anmeldedatum:
10. November 2004 (10.11.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 52 402.9 10. November 2003 (10.11.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **LASERTEC GMBH** [DE/DE]; Maybachstrasse 6,
87437 Kempten (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **EITERER, Alfons**
[DE/DE]; Kurfürstenallee 34, 87616 Marktoberdorf (DE).
HILDEBRAND, Peter [DE/DE]; Mühlenbichlweg
18, 87459 Pfronten (DE). **KUHL, Michael** [DE/DE];
Feistlestrasse 12b, 87629 Füssen (DE). **REISACHER,**
Martin [DE/DE]; Mariabergerstrasse 69 a, 87435
Kempten (DE).

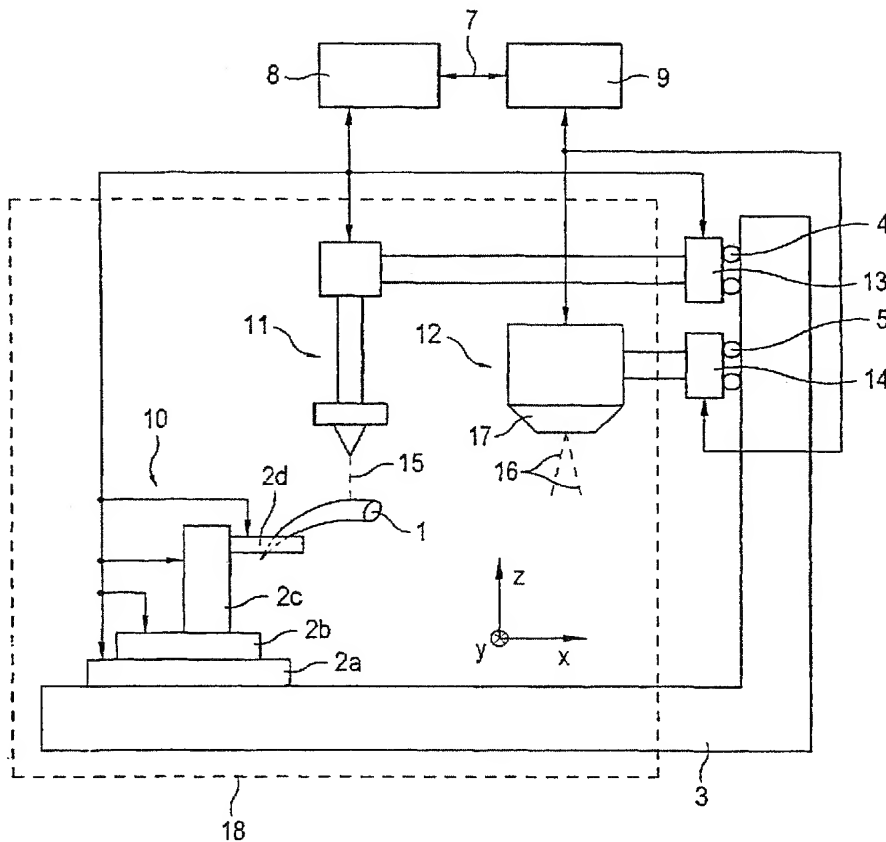
(74) Anwalt: **BEETZ & PARTNER**; Steinsdorfstrasse 10,
80538 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: LASER MACHINING APPARATUS AND LASER MACHINING METHOD

(54) Bezeichnung: LASERBEARBEITUNGSMASCHINE UND LASERBEARBEITUNGSVERFAHREN



(57) Abstract: Disclosed is a laser machining apparatus comprising a workpiece fixture (10) for fastening a workpiece (1), a first laser removing device (11) for machining a workpiece using first operating parameters, and a second laser removing device (12) which can machine a workpiece using second operating parameters that are different from the first operating parameters, especially regarding the quality and quantity.

(57) Zusammenfassung: Eine Laserbearbeitungsmaschine weist eine Werkstückhalterung (10) zur Halterung eines Werkstücks (1) auf, eine erste Laserabtragsvorrichtung (11) zur Bearbeitung eines Werkstücks mit ersten Arbeitsparametern und eine zweite Laserabtragsvorrichtung (12), die ein Werkstück mit zweiten Arbeitsparametern, die insbesondere qualitativ und/oder quantitativ unterschiedlich zu den ersten Arbeitsparametern sind, bearbeiten kann.



KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- mit geänderten Ansprüchen

Veröffentlichungsdatum der geänderten Ansprüche:

14. Juli 2005

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.